

EV Group expands collaboration with ITRI on heterogeneous integration process development – September 1, 2022

EVG announced that it has expanded its collaboration with the ITRI, one of the world’s leading applied technology research institutes based in Hsinchu, Taiwan, on developing advanced heterogeneous integration processes. As a member of the Hi-Chip Alliance, EVG has provided several of its most advanced wafer bonding and lithography systems, including the LITHOSCALE® maskless exposure lithography system, EVG@850 DB automated debonding system, and GEMINI®FB hybrid bonding system. “Key to our Triple-i philosophy of invent-innovate-implement is our focus on engaging with world-leading research institutes, like ITRI, to accelerate the development and commercialization of new technologies that drive future innovations in the semiconductor industry.” stated Hermann Waltl, executive sales and customer support director and member of the executive board at EVG.

전원 관리 도구
쉽고 최적화된 완벽한 전원 시스템 설계

LTPowerPlanner LTPowerCAD LTopic

다운로드 ▶

ANALOG DEVICES
AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™



EV Group, 이종 집적 프로세스 개발을 위해서 ITRI와 협력 확대

최 노태민 기자 | © 압력 2022.09.01 18:24 | 댓글 0

TEXAS INSTRUMENTS

7의 절연 강벽이 어떻게 더 저렴한 시스템 비용으로 수명을 연장하는지 알아보세요

기술백서 읽기



EV Group의 LITHOSCALE 마스크리스 노광 리소그래피 설비. [사진=EV Group]

[테크월드뉴스=노태민 기자] MEMS, 나노기술, 반도체 시장용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 기업 EV Group(EVG)은 대만 신주에 위치한 응용 기술 연구소 ITRI(Industrial Technology Research Institute)와 첨단 이종 집적 기술 개발을 위한 협력을 확대한다고 밝혔다.

대만 경제부 산업 기술처의 지원을 통해, ITRI는 패키지 설계, 테스트 및 검증, 그리고 파일럿 생산을 아우르는 생태계를 형성함으로써 공급망 현지화 달성 및 사업 기회 확대에 기여하기 위한 목적으로 Hi-CHIP(Heterogenous Integration Chip-let System Package) 협력체를 구성했다.

EVG는 Hi-CHIP 협력체의 회원사로서 LITHOSCALE 마스크리스 노광 리소그래피 설비, EVG850 DB 자동 디본딩 설비, GEMINI FB 하이브리드 본딩 설비 같은 첨단 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 설비를 제공한다. ITRI의 최신 연구 시설에 이 같은 대량 생산 설비들이 설치됨에 따라 앞으로 EVG와 ITRI의 공동 고객들은 새로운 이종 집적 프로세스를 빠르게 개발하고 R&D에서 고객의 팹으로 신속히 이전할 수 있게 되었다.

반도체 제조 영역에서, 3D 수직 적층 및 이종 집적이란 다수의 서로 다른 부품들과 다이를 단일 디바이스나 패키지로 제조, 조립 및 패키징 하는 것을 말하는데, 이는 단지 트랜지스터 크기를 축소하기 위한 목적을 넘어 계속해서 더 높은 성능을 달성하기 위해서 점점 더 중요해지고 있다.

3D 및 이종 집적은 첨단 패키징에서 고대역폭 인터커넥트를 가능하게 하므로 전반적인 시스템 성능을 향상시킬 수 있어 인공 지능(AI), 자율 주행, 기타 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 위해서 중요한 역할을 한다. 이 때문에 대만 경제부는 'AI 칩 이종 집적 모듈 첨단 제조 플랫폼'이나 '프로그래머블 이종 3D 집적' 같은 국가적 차원의 R&D 프로젝트를 통해서 필요한 자원들을 적극적으로 지원 및 연결하고 있다.

허만 발틀(Hermann Walt) EVG의 영업 및 고객 지원 책임자는 "EVG는 Triple i(invent-innovate-implement) 원칙을 기반으로 ITRI 같은 세계적 연구소와 협력 관계를 맺고 반도체 산업의 혁신을 가속화하는 첨단 기술 개발과 상용화에 참여하고 있다"며, "ITRI와의 지속적인 협력은 세계적인 연구소와 교류의 장을 마련하고 대만에서 EVG의 프로세스 지원 인프라를 더욱 강화하도록 한다"고 밝혔다.

<http://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=227400>